

1

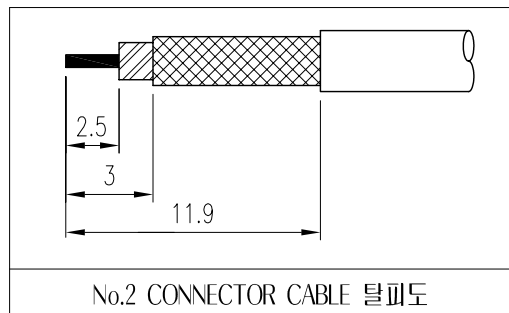
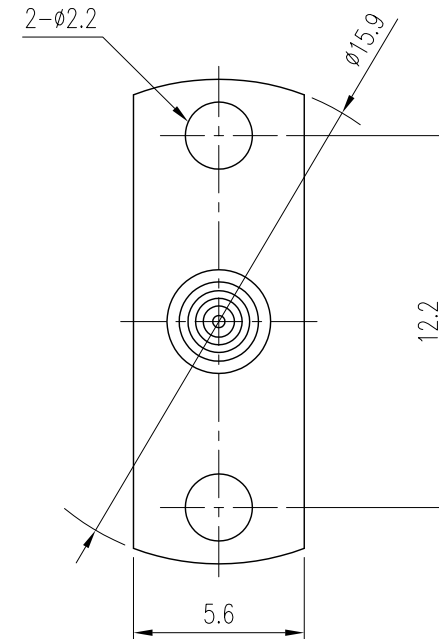
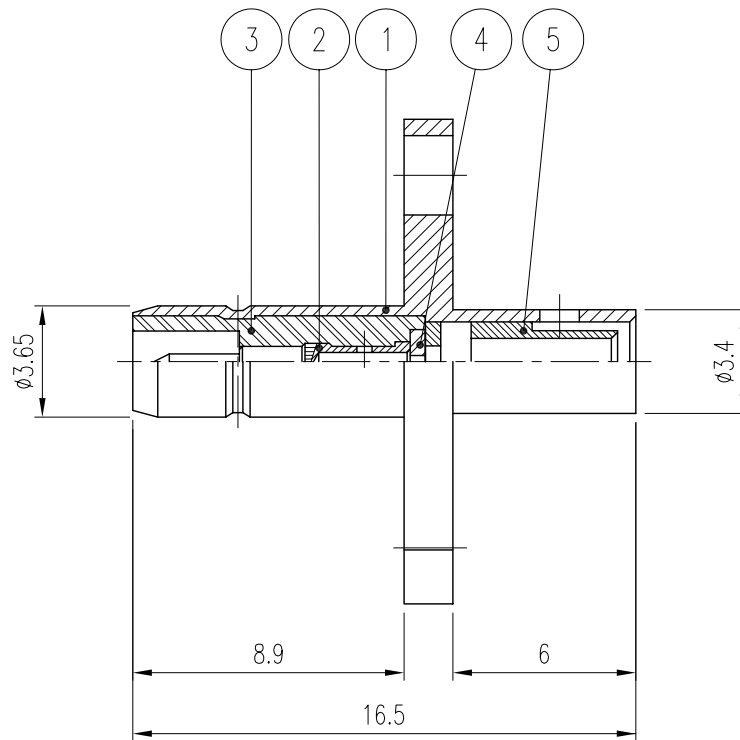
2

3

4

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
0	최 초 개 정	김인철	윤상진	2008. 11. 4.



5	INSERT	1	MBsBD	Gold Plate	DIS00129-5/1
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01412-N/1
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01148-N/1 (H2350)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT01748-5/1
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD02224-5/1

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 2008. 11. 4.				 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		
	승인	Y . S . J					
재질	검도	K . E . H			도명	SMB-JS-H2-MHC231 VER.0	
열처리	재도	K . I . C					
보호파막처리	작성부서 연 구 소				A4	도번	CN02215-7/1
	척도 1.5/1	단위 mm	중량				

1

2

3

4